Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-signum-m30-air-ey2a019-p-381433.html

Obudowa Signum M30 Air EY2A019



Cena brutto	**210,99 zł**
Cena netto	**171,54 zł**
Numer katalogowy	**KOENDOD0EY2A019**
Kod producenta	**EY2A019**
Maksymalna długość zasilacza	**180**
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	**4**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 240 mm (przód)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**7**
Zainstalowane wentylatory	**2 x 120 mm (przód)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**3**
Podświetlenie obudowy	**Nie**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**36 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**159**
Maksymalna długość karty graficznej	**345**
Format obudowy	**FlexATX**
Typ obudowy	**Mini Tower**
Złącza na przednim panelu	**1 x słuchawki**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**2**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**4**
Waga	**4.5**
Akcesoria w zestawie	**Obudowa ENDORFY Signum M30 Air 3 x Preinstalowany wentylator Stratus 120 PWM Preinstalowany rozdzielacz wentylatorów PWM Zestaw montażowy Instrukcja obsługi**
Wymiary	**387 x 205 x 401 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

ENDORFY Signum M30 Air

ENDORFY Signum M30 Air to kompaktowa obudowa microATX, która oferuje szerokie możliwości konfiguracji. Przewiewna konstrukcja z panelem mesh, trzema fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami Stratus 120 PWM oraz filtrami przeciwkurzowymi pomaga utrzymać stabilne temperatury, a panel z hartowanego szkła i szybki port USB-C podkreślają nowoczesny charakter całości.

Przewiewne wnętrze i ochrona przed kurzem
Obudowa Signum M30 Air została zaprojektowana z myślą o efektywnym chłodzeniu podzespołów. Frontowy panel mesh wspierany przez dwa fabrycznie zamontowane wentylatory zapewnia swobodny dopływ powietrza do wnętrza.

Ciepło jest skutecznie odprowadzane przez tylny wentylator oraz perforowaną górną część konstrukcji, co sprzyja utrzymaniu stabilnych temperatur podczas pracy komputera. Obudowa umożliwia montaż do siedmiu wentylatorów 120 mm. Dwa magnetyczne filtry oraz przedni panel mesh, który również pełni funkcję filtra przeciwkurzowego, można łatwo zdjąć bez użycia narzędzi i wyczyścić.

Trzy preinstalowane wentylatory PWM
W komplecie z obudową Signum M30 Air znajdują się trzy fabrycznie zamontowane wentylatory Stratus 120 PWM, podłączone do preinstalowanego splittera. Dzięki temu wystarczy podpiąć jedno złącze 4-pin PWM do sterowania nimi z poziomu płyty głównej. Wentylatory, opracowane wspólnie z Synergy Cooling, łączą wysoką wydajność z cichą pracą. Zastosowane łożysko FDB zapewnia długą żywotność, a sterowanie PWM umożliwia precyzyjną regulację obrotów, w tym także pracę w trybie fan stop.

Panel ze szkła i miejsce na ukrycie kabli
Boczny panel z hartowanego szkła nadający nowoczesny wygląd obudowie pozwala wyeksponować podzespoły komputera. Przestrzeń za tacką płyty głównej oraz odpowiednio rozmieszczone przepusty i punkty montażowe na opaski zaciskowe umożliwiają schludne poprowadzenie oraz ukrycie kabli. Odpowiednie ułożenie przewodów ułatwia utrzymanie porządku wewnątrz obudowy, poprawia estetykę zestawu i sprzyja lepszemu przepływowi powietrza.

Rozbudowane możliwości w kompaktowym formacie
Dwukomorowa zgrabna konstrukcja obudowy została zaprojektowana z myślą o płytach głównych microATX, a także kompatybilności z mniejszymi formatami Mini-ITX i FlexATX. Signum M30 Air umożliwia montaż nowoczesnych komponentów, w tym długich kart graficznych (do 345 mm), wydajnych układów chłodzenia (powietrzne o wysokości do 159 cm, chłodnice 240 mm) oraz kilku nośników danych (dwa dyski 2,5 i dwa dyski 3,5). Obudowa jest też zaopatrzona w cztery sloty kart rozszerzeń z wykręcanymi maskownicami, co ułatwia konfigurację zestawu dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Nowoczesny panel złącz z USB-C
Na górnej ściance Signuma umieszczono funkcjonalny panel I/O, zapewniający wygodny dostęp do najczęściej używanych portów. Do dyspozycji są dwa złącza USB-A 3.2 Gen 1 (do 5 Gb/s), para gniazd audio 3,5 mm (do słuchawek lub głośników i mikrofonu) oraz bardzo szybki port USB-C 3.2 Gen 2×2 o przepustowości do 20 Gb/s. Umożliwia to komfortowe podłączanie urządzeń i akcesoriów bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

ENDORFY Signum M30 Air - główne cechy:

- Trzy preinstalowane wentylatory Stratus 120 PWM
- Przewiewny i łatwo dostępny front
- Praktyczne magnetyczne filtry przeciwkurzowe
- Kompatybilność z chłodnicami do 240 mm
- Kompatybilność z coolerami wieżowymi do 159 mm
- Kompaktowe wymiary i dobre możliwości aranżacji podzespołów
- Panel boczny z hartowanego szkła
- Dobre chłodzenie komponentów
- Szybkie USB-C na górnym panelu
- Wygodne rozwiązania do zarządzanie kablami